

## 5 Обесцвечивание печатной платы


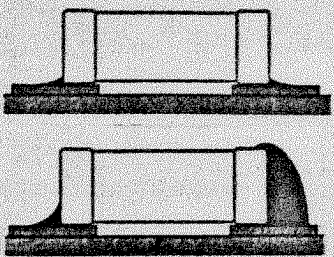
5.1 Допускается небольшое однородное обесцвечивание печатной платы согласно утвержденному эталону.

## 6 Контроль паяных соединений

6.1 Рекомендуется для паяных соединений иметь одинаковое количество припоя на всех однотипных выводах, обеспечивающее вогнутую форму припойных швов и соответствующую высоту мениска.

6.1.1 Требования к пайке безвыводных компонентов с металлизированными контактными площадками (резисторы, конденсаторы и т.д.).

Таблица 13

Требование к пайке	Графическое изображение	Описание
Предпочтительно		Для компонентов с высотой металлизации "Н" менее 1,2 мм высота мениска более 1/3 высоты "Н". Для элементов с "Н", равной или более 1,2 мм, высота мениска более 0,4 мм.
Приемлемо		Для компонентов с высотой металлизации "Н" менее 1,2 мм высота мениска не менее 1/3 высоты "Н". Для элементов с "Н", равной или менее 1,2 мм, высота мениска не менее 0,4 мм. Пайка швов имеет вогнутую форму.
Требуется переработка		Для компонентов с высотой металлизации "Н" менее 1,2 мм высота мениска равна или менее 1/3 высоты "Н". Для элементов с "Н", равной или более 1,2 мм, высота мениска равна или менее 0,4 мм. Пайка шва имеет выпуклую форму.

					БЖАК.680242.001 ОТТ		Лист
Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата			11
13039 / Т		Досет 13.09.01					
Инв N подл		Подп и дата		Взам инв N	Инв N дубл	Подп и дата	